



2026 年 7 月 29 日

各 位

会社名 株式会社 小森コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 持田 訓
(コード番号 6349 東証プライム)
問合せ先 取締役グローバル経営管理統括本部
統括本部長 橋本 巖
(TEL 03 - 5608 - 7826)

丸山チラー株式会社の株式取得（子会社化）に関する株式譲渡契約締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、丸山チラー株式会社（代表取締役：丸山英人、本社：東京都八王子市、以下「丸山チラー」といいます。）の発行済株式の全てを取得（以下「本株式取得」といいます。）し、丸山チラーを完全子会社化するため、株式譲渡契約（以下「本株式譲渡契約」といいます。）を締結することを決議し、同日付で本株式譲渡契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式取得の理由

当社グループは、大正 12 年の創業以来、品質と信頼を至上とするものづくりの原点にこだわり、印刷機械メーカーとして邁進してまいりましたが、足許においては新事業領域として、プリンテッドエレクトロニクス及びデジタルプリンティングシステムの分野に注力しております。また、2025 年 3 月期より開始された第 7 次新中期経営計画では新事業領域の拡大を企図しており、特にプリンテッドエレクトロニクス事業（以下「P E 事業」といいます。）の強化は必須と捉えております。当社グループでは、P E 事業を当社子会社の株式会社セリアコーポレーションで展開しており、同社は基板製造向けの製造装置を主軸として展開しておりますが、当社の保有するプリントテクノロジーを活用した製造装置を新たな市場に向けて事業拡大を図るにあたり、顧客基盤の拡大が課題となっております。

丸山チラーは、昭和 44 年の創業以来、「ものづくりの技術の頂点を追求し、世界に通じる製品を生産し、社会に貢献する。」ことを経営理念とし、一台ごとに顧客の仕様やサイズに合わせて柔軟かつ的確に設計・製作するオーダーメイド体制や、高温から超低温にいたる高精度な温度制御技術等、半導体製造分野において高度な専門性と実績を有し、チラー製作のリーディングカンパニーとして日本国内外の多数のクライアントに対して提供しております。また、国際的な安全規格認証を数多く取得するなど特に品質に強い拘りを持ったチラー製作、販売を行っており、日本のみならず、台湾、上海、アメリカ及びシンガポールを基点に世界規模の取引を行っております。

今回の丸山チラーの完全子会社化により、丸山チラーの東京、台湾、上海、アメリカ及びシンガポールを基点とする強固かつ世界規模の顧客基盤を活用することにより、当社の半導体製造分野への事業領域拡大を図るとともに、丸山チラーの確かな技術力と、長年のチラー製造・販売実績により築き上げられたエンドユーザーとの信頼関係を基盤として、市場の大きな需要に応え得る生産能力の増強及び量産対応力の強化を実現させることにより、チラー事業の持続的な成長を通して当社 P E 事業の飛躍的かつ高水準での成長を維持させるものと確信しております。

これらのシナジーを最大化することで、両社の技術・人財・生産基盤を融合し、半導体分野における競争優位性を中長期的に確立させることにより、当社の企業価値向上に大きく寄与するものと考えております。

2. 異動する子会社（丸山チラー）の概要

(1) 名称	丸山チラー株式会社		
(2) 所在地	東京都八王子市諏訪町 263 番 1 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 丸山 英人		
(4) 事業内容	半導体製造装置向けチラー（恒温循環装置）の開発・設計・製造・販売・アフターサービス		
(5) 資本金	30 百万円		
(6) 設立年月日	1995 年 1 月 6 日		
(7) 大株主及び持株比率	丸山 英人（100.0％）		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の財政状態及び経営成績			
決算期	2023 年 12 月期	2024 年 12 月期	2025 年 12 月期
純資産	5,510 百万円	6,052 百万円	6,417 百万円
総資産	10,246 百万円	10,664 百万円	12,979 百万円
1 株当たり純資産	9,184 千円	10,088 千円	10,696 千円
売上高	7,744 百万円	5,762 百万円	8,164 百万円
営業利益	1,979 百万円	634 百万円	661 百万円
経常利益	2,320 百万円	989 百万円	748 百万円
当期純利益	1,343 百万円	542 百万円	364 百万円
1 株当たり当期純利益	2,239 千円	903 千円	607 千円
1 株当たり配当金	— 円	— 円	— 円

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	丸山 英人
(2) 住所	東京都港区
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0.0%)
(2) 取得株式数	600 株 (議決権の数：600 個)
(3) 取得価額	丸山チラー株式会社普通株式 26,000 百万円 アドバイザー費用等（概算額）463 百万円 合計（概算額）26,463 百万円
(4) 異動後の所有株式数	600 株 (議決権の数：600 個) (議決権所有割合：100.0%)

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2026 年 7 月 29 日
(2) 本株式譲渡契約締結日	2026 年 7 月 29 日
(3) 本株式取得実行日	2026 年 10 月 2 日 (予定)

6. 今後の見通し

当社の 2027 年 3 月期第 3 四半期決算より丸山チラーは当社の連結子会社となる予定です。

本株式取得に伴う連結業績及び財務状況に与える影響につきましては現在精査中であり、今後公表すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

(参考) 当期連結業績予想 (2026 年 5 月 14 日公表分) 及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
当期連結業績予想 (2027 年 3 月期)	124,000 百万円	9,500 百万円	9,200 百万円	7,200 百万円
前期連結実績 (2026 年 3 月期)	118,611 百万円	9,404 百万円	10,718 百万円	7,371 百万円

以上

(参考資料)

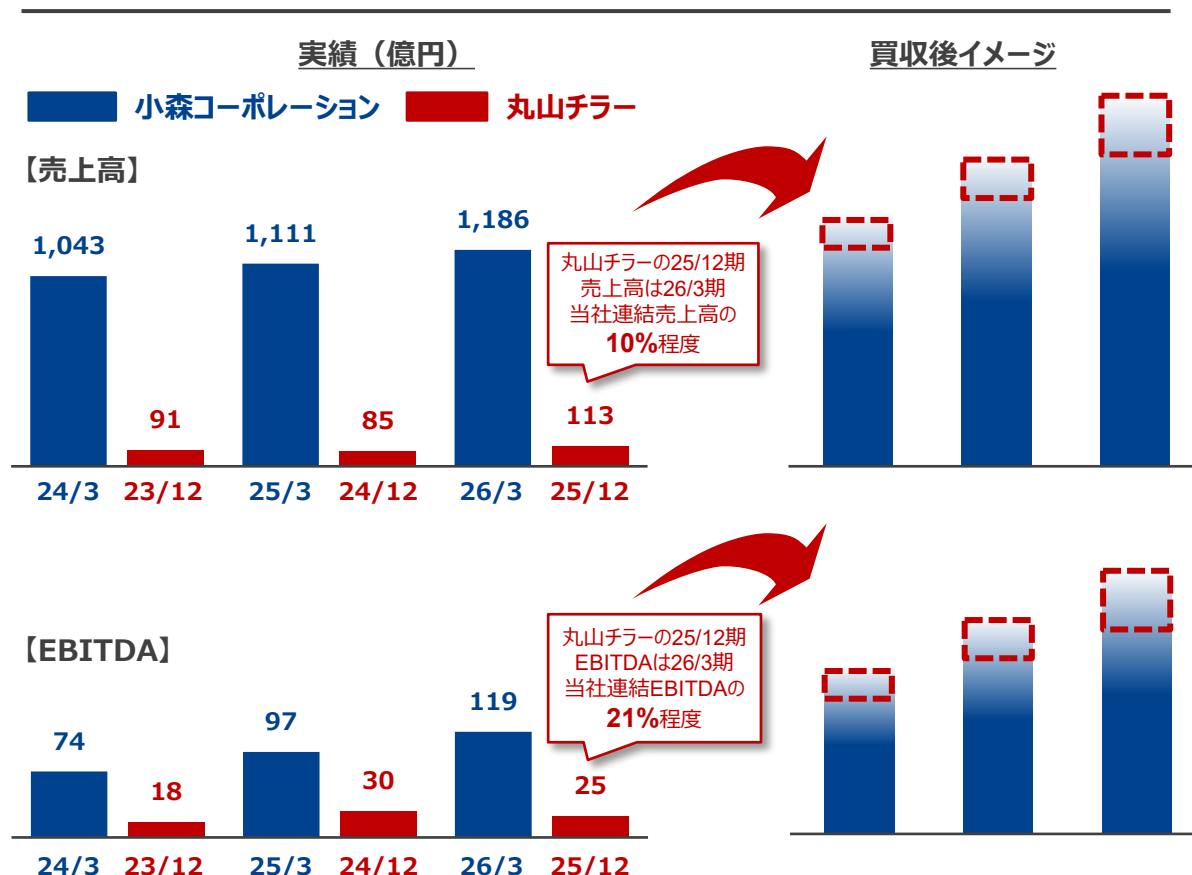
丸山チラー株式会社の株式取得（子会社化）について

2026年7月29日

株式会社 小森コーポレーション

第7次中期経営計画及び長期ビジョン「KOMORI 2030」の達成に向け、半導体製造領域への本格的な参入を目的として、丸山チラー株式会社の株式を取得

買収後の小森コーポレーション連結業績イメージ



想定シナジー



- 半導体製造分野へ事業領域拡大
 - ✓ 丸山チラーは世界的な半導体製造メーカーおよび半導体製造装置メーカーを顧客基盤として保有
- 生産能力とサポート体制の強化
 - ✓ KOMORIの経営資源・グローバルネットワークの活用による丸山チラーの生産インフラ強化を通じて、急速に高まっている顧客のチラー需要に応えるとともに、さらなる海外事業の拡大を加速

注：丸山チラーの売上高およびEBITDAは監査法人による監査を受けた数値ではありません。対象期間において費用等計上の期ずれが見られますが、業績は堅調に推移しております。

会社概要

会社名	丸山チラー株式会社 (Maruyama Chiller Corporation)
設立	1995（平成7）年1月6日
本社	東京都八王子市諏訪町263-1
代表者	代表取締役社長 丸山 英人
海外拠点	米国、中国（上海）、台湾、シンガポール（販売代理店）
事業内容	半導体製造装置向け恒温循環装置(チラー・サーキュレーター)の開発・設計・製造・販売・アフターサービス
従業員数	100名（2026/6/30時点）
主要取引先	半導体製造装置メーカー、半導体製造メーカー等
認定	UL、CE、SEMI、NRTLといった国際的な安全規格の認証を数多く取得

拠点

◆ 主な国内事業所

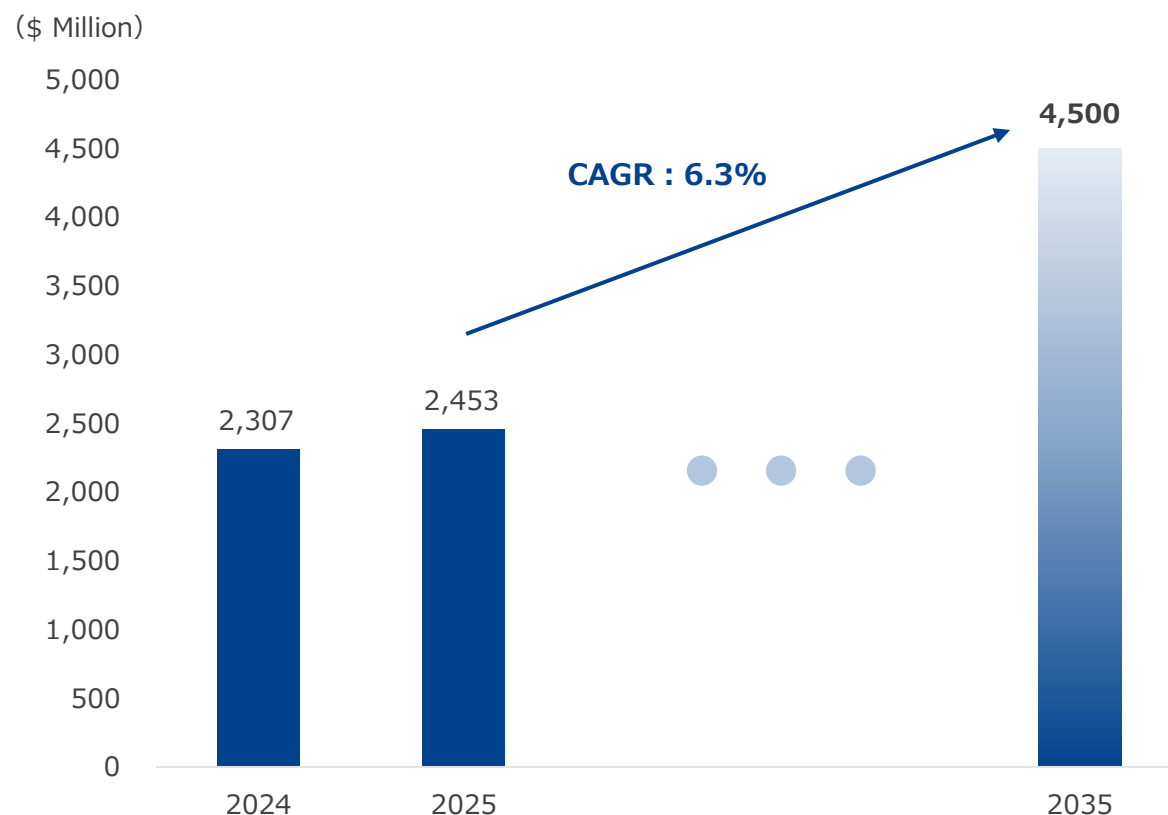
名称	本社	八王子技術センター
住所	東京都八王子市諏訪町263-1	東京都八王子市明神町3-20-6 八王子ファーストスクエア 11階

◆ 主な海外事業所（子会社）

社名	Risshi America, Inc.	丸龍商貿（上海）有限公司 Wanlong Trading (Shanghai) Co.,Ltd.	群力科技股份有限公司 Chilltech Corporation	台灣力施科技股份有限公司 Risshi Taiwan Corporation
住所	米国 （カリフォルニア州）	中国 （上海）	台湾	台湾

- ・半導体製造装置向けチラーの市場規模は2025年の約\$2,500 Millionから2035年の\$4,500 Millionに拡大すると推定（CAGR：6.3%、2026-2035）
- ・成長要因は、アジアを中心とした半導体製造設備投資の増加による需要拡大

半導体製造装置向けチラー市場規模の推移（推定）



成長要因

半導体市場の拡大

- ◆ 世界半導体市場は、AI・データセンター需要の拡大とIC（集積回路）の高集積化を主因に右肩上がり成長し、2034年には\$1,477 Billion（2025年は\$598 Billion）に拡大すると推定（CAGR：10.6%、2026-2034）

半導体製造装置向けチラー市場の拡大

- ◆ AIや先端プロセスの高度化に伴う、高精度・省エネな温度制御ニーズの高まりが市場を形成
- ◆ 特に中国、韓国、台湾などにおける半導体製造工場の急拡大により、アジア地域が半導体製造装置向けチラー市場を牽引する見通し
- ◆ 米国ではCHIPS Act*1を背景とした半導体製造回帰に加え、AI需要を受けた半導体製造装置メーカーの大型投資が進展しており、チラー市場の成長を後押し

- ・プリントテクノロジーの半導体製造領域への拡大に向けた戦略投資の実行
- ・顧客基盤を印刷から半導体へ拡張し、事業ポートフォリオの成長性を高める

技術基盤強化



環境配慮型製品
要素技術開発

スマートファクトリー
を構成する
要素技術開発

インクジェット印刷
コア技術開発

プリンテッド
エレクトロニクス
技術開発

生産体制/サプライチェーン刷新



工場体制見直しによる
生産性向上、モノづくり革新
およびスマートファクトリー化

知覚品質体制強化による
製品価値、ブランド力向上と
グローバル品質管理

グローバル調達拡大と
サプライチェーンとの
共同VE活動強化

人財／組織強化



新技術領域の
人財ポートフォリオ
の再構築

成長市場の
インド・アジア地域の
販売・サービス体制
強化

海外人財の
執行幹部への登用と
グローバル人事の
仕組み構築

KOMORI流働き方改革
「K-Work」による
職場環境・人財管理・
ダイバーシティへの取り組み

戦略投資
総額200億円
M&Aを含む
・技術開発投資
・生産設備投資
・人財投資

※但し、投資先の状況や市況に
応じ、計画金額に限定されない
機動的な投資を実行

KOMORI